

关键指标

- 频率: 0.8~2.5GHz
- 增益: 36dB
- 噪声系数: 0.5dB
- 1dB 压缩点输出功率: 18.5dBm
- 电压/电流: +5V/58mA
- 芯片尺寸: 12.7mm×8.89mm

产品简介

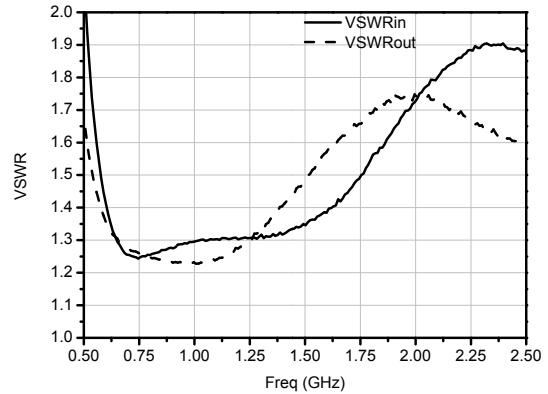
HG112F7-Q09 是一款 0.8~2.5GHz 低噪声放大器封装芯片, 增益为 36dB, 噪声系数 0.5dB, 1dB 压缩点输出功率为 18.5dBm。

电性能 (T_A=25°C, V_d=+5V)

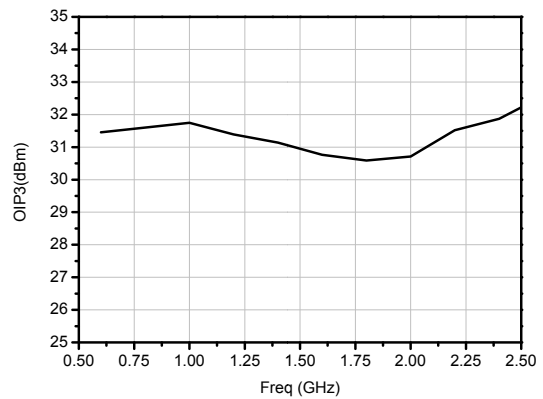
指标	最小值	典型值	最大值
频率(GHz)	0.8~2.5		
增益(dB)	—	36	—
增益平坦度(dB)	—	±1.3	—
输入驻波	—	1.5	—
输出驻波	—	1.4	—
噪声系数(dB)	—	0.5	—
1dB 压缩点输出功率(dBm)	—	18.5	—

典型测试曲线

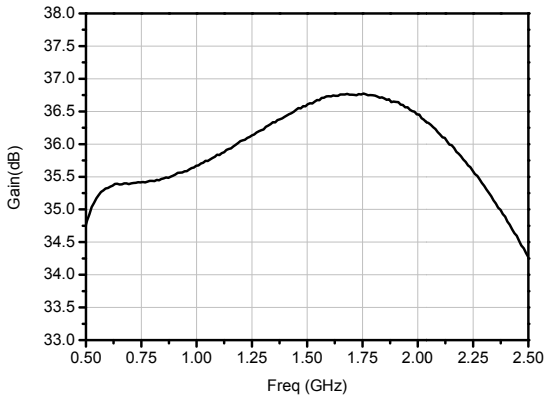
输入驻波



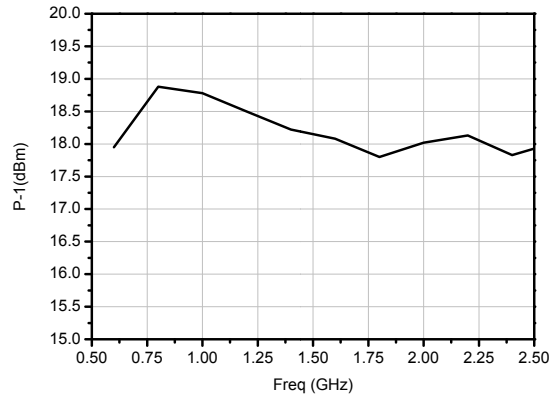
OIP3 (P_{out}=2dBm)



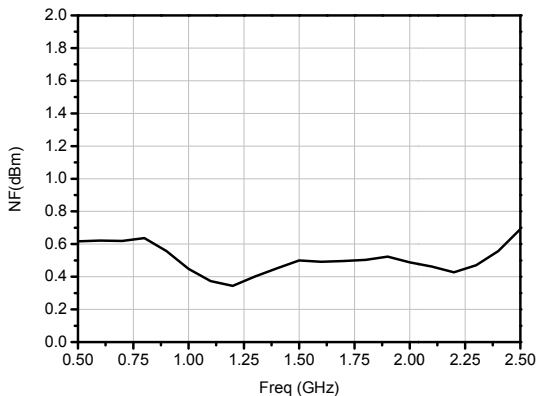
增益



1dB 压缩点输出功率



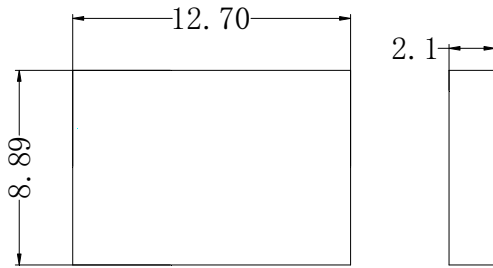
噪声系数



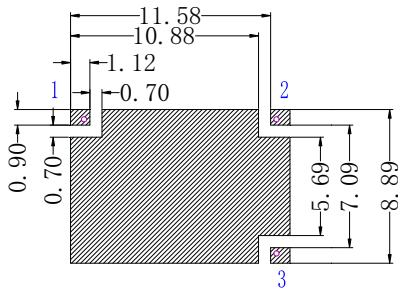
绝对额定最大值

工作电压	+5.5V
最大输入功率	+15dBm
工作温度	-55°C~125°C
存储温度	-65°C~150°C

外形和端口尺寸 (mm)



推荐装配图



端口说明

端口号	端口说明
1	RFin
2	RFout
3	Vdd

注意事项

1. 产品在干燥环境中储存和使用，并注意防静电；
2. 产品用导电胶或铅锡烧结（合金温度不能超过 185°C，时间不能超过 30 秒），使之充分接地；